

# ガラス基板加熱・冷却装置

特殊設計品

ガラス基板の加熱・冷却における製造プロセスを確立するために最適化された装置



## 特 長

ガラス基板の温度プロファイルを取ることにより、最適な加熱または冷却条件を見だし、プロセス設計の迅速化を実現します。基板温度の昇降試験に最適な装置です。

- ガラス基板の加熱・冷却における製造プロセスを確立するため最適化された装置です。
- ホットプレート部・クールプレート部には、長年にわたり培ってきた、均熱技術を用いています。
- クリーンルームでの使用を考慮した構造です。

## 仕 様

寸 法	ホットプレート	(W) 700 × (L) 600 × (H) 40 mm
	クールプレート	(W) 700 × (L) 600 × (H) 40 mm
主要材料	ホットプレート	A5052 (アルミニウム)
	クールプレート	A5052 (アルミニウム)
設定可能範囲	加熱時間	0 ~ 999秒
	冷却時間	0 ~ 999秒

温 度 設 定 範 囲	ホットプレート	50 ~ 300°C
	クールプレート	5 ~ 30°C
温 度 均一 性	ホットプレート	200°C以下 ±1°C (550×650 mm内) 200°C超 ±2°C ( )
	クールプレート	5°C ~ 30°C ±2°C ( )
質 量		約500kg

# 熱板式リフロー半田付け装置

特殊設計品

冷却ユニット付き連続リフロー炉



## 特 長

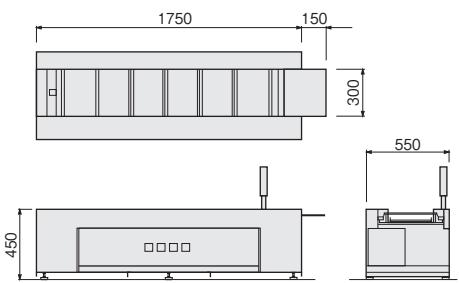
治具を使用して多量の半田付けを行います。

4つの均熱板と、1つの冷却ゾーンを持つリフロー半田付け装置です。

高温半田まで対応可能です

- 均熱熱板を使用していますので、品質の安定化が計れます。
- ワークの搬送は自動で、スピードコントロールが自由に設定できます。
- 小型、コンパクト設計です。
- 単独での使用の他、ライン組み込みも自由にできます。

## 寸 法・仕 様



処理部品 (ワーク)	基板(治具保持) 最小t5×幅20×長さ80
処理温度	350°C max (熱板温度) 可変
温度精度	±3°C (熱板表面温度)
外形寸法	幅550mm × 長さ1750mm × 高さ450mm (アンローダーシューター除く)

治具の大きさは、最小で幅20mm 厚さt5